

Title (en)
Method for vacuum assembling a flat display

Title (de)
Verfahren zum Vakuumzusammenbau eines flachen Bildschirms

Title (fr)
Procédé d'assemblage sous vide d'un écran plat de visualisation

Publication
EP 0895268 A1 19990203 (FR)

Application
EP 98410083 A 19980728

Priority
FR 9709917 A 19970729

Abstract (en)
The vacuum assembly method in an oven assembles two parallel screens (1,4) in an internal space (6). The peripheral sealing is effected in two steps. In the first step, a first sealing joint (5) is sealed, maintaining open a second hole (13) of communication with the internal space. In a second step, a closure element (16) seals a second sealing unit (15) sealed at a second temperature lower than the first sealing temperature.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'assemblage, dans un four sous vide ou sous atmosphère neutre, de deux plaques parallèles (1, 4) avec ménagement d'un espace interne (6) clos, consistant dans une première étape, à effectuer un scellement périphérique au moyen d'un premier joint fusible (5) à une première température en maintenant ouvert au moins un orifice (13) de communication avec l'espace interne et, dans une deuxième étape, à fermer ledit orifice au moyen d'un élément de fermeture (16) avec interposition d'un deuxième joint fusible (15) à une deuxième température inférieure à la première température. <IMAGE>

IPC 1-7
H01J 9/26

IPC 8 full level
H01J 5/02 (2006.01); **H01J 5/24** (2006.01); **H01J 9/24** (2006.01); **H01J 9/26** (2006.01); **H01J 29/86** (2006.01); **H01J 29/94** (2006.01); **H01J 31/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01J 9/261 (2013.01 - EP US); **H01J 2217/49** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 4666548 A 19870519 - ETO GORO [JP], et al
- [X] US 4182540 A 19800108 - FRANKLAND ROGER A [US], et al
- [A] FR 2234647 A1 19750117 - IBM [US]
- [A] US 4139250 A 19790213 - JACOBS JACOBUS H, et al
- [A] FR 2724047 A1 19960301 - PIXEL INT SA [FR]
- [A] FR 2225833 A1 19741108 - IBM [US]
- [A] FR 2709374 A1 19950303 - FUTABA DENSHI KOGYO KK [JP]
- [A] DE 2718273 A1 19771027 - ISE ELECTRONICS CORP
- [A] GB 2261320 A 19930512 - SMITHS INDUSTRIES PLC [GB]
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 636 (E - 1464) 25 November 1993 (1993-11-25)

Cited by
FR2795230A1; US6459198B1; WO0188942A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 0895268 A1 19990203; FR 2766964 A1 19990205; FR 2766964 B1 19991029; JP H11120918 A 19990430; US 6146228 A 20001114

DOCDB simple family (application)
EP 98410083 A 19980728; FR 9709917 A 19970729; JP 22520198 A 19980727; US 12328098 A 19980728